

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制

深圳至正高分子材料股份有限公司拟通过重大资产置  
换、发行股份及支付现金的方式购买股权所涉及的  
Advanced Assembly Materials International Limited  
股东全部权益价值  
资产评估报告

中联沪评字[2025]第8号

中联资产评估咨询（上海）有限公司

二〇二五年二月二十八日



# 中国资产评估协会

## 资产评估业务报告备案回执

报告编码:	3131210012202500003
合同编号:	2409S0034A-00
报告类型:	法定评估业务资产评估报告
报告文号:	中联沪评字[2025]第8号
报告名称:	深圳至正高分子材料股份有限公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式购买股权所涉及的Advanced Assembly Materials International Limited 股东全部权益价值
评估结论:	3,526,000,000.00元
评估报告日:	2025年02月28日
评估机构名称:	中联资产评估咨询(上海)有限公司
签名人员:	余海波 (资产评估师) 正式会员 编号: 32180135 唐自鹏 (资产评估师) 正式会员 编号: 32190091

余海波、唐自鹏已实名认证



(可扫描二维码查询备案业务信息)

说明: 报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案, 不作为协会对该报告认证、认可的依据, 也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。

备案回执生成日期: 2025年02月28日

ICP备案号京ICP备2020034749号

## 目 录

声 明 .....	1
摘 要 .....	3
一、 委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 .....	5
二、 评估目的 .....	20
三、 评估对象和评估范围 .....	21
四、 价值类型 .....	32
五、 评估基准日 .....	32
六、 评估依据 .....	32
七、 评估方法 .....	36
八、 评估程序实施过程和情况 .....	47
九、 评估假设 .....	49
十、 评估结论 .....	51
十一、 特别事项说明 .....	55
十二、 评估报告使用限制说明 .....	56
十三、 评估报告日 .....	62
附 件 .....	64



## 声 明

一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。

二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及其资产评估专业人员不承担责任。

本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象的可实现价格，评估结论不应当被认为是对其评估对象可实现价格的保证。

三、委托人和其他相关当事人所提供资料的真实性、合法性、完整性是评估结论生效的前提，纳入评估范围的资产、负债清单以及评估所需的预测性财务信息、权属证明等资料，已由委托人、被评估单位申报并经其采用盖章或其他方式确认。

四、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。

五、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关



当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。

六、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

七、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。



# 深圳至正高分子材料股份有限公司拟通过重大资产置 换、发行股份及支付现金的方式购买股权所涉及的 Advanced Assembly Materials International Limited 股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告

中联沪评字[2025]第 8 号

## 摘 要

中联资产评估咨询（上海）有限公司接受深圳至正高分子材料股份有限公司的委托，就深圳至正高分子材料股份有限公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式购买 Advanced Assembly Materials International Limited（中文名称：先进封装材料国际有限公司，简称：“AAMI”）的股权之经济行为，对所涉及的 Advanced Assembly Materials International Limited 股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。

评估对象为 Advanced Assembly Materials International Limited 股东全部权益，评估范围是 Advanced Assembly Materials International Limited 全部资产及相关负债，包括流动资产和非流动资产及相应负债。

评估基准日为 2024 年 9 月 30 日。

本次评估的价值类型为市场价值。

本次评估结合委估对象的实际情况，在本次评估的特定假设下，综合考虑各种影响因素，分别采用资产基础法和市场法两种方法对 Advanced Assembly Materials International Limited 进行整体评估，然后加以校核比较。考虑评估方法的适用前提和满足评估目的，本次选用市



场法评估结果作为最终评估结果。

采用市场法，得出被评估单位在评估基准日 2024 年 9 月 30 日合并口径股东全部权益账面值 296,593.77 万元，评估值 352,600.00 万元（百万位取整，大写：叁拾伍亿贰仟陆佰万元整），评估增值 56,006.23 万元，增值率 18.88%。

在使用本评估结论时，特别提请报告使用者使用本报告时注意报告中所载明的特殊事项以及期后重大事项。

评估结果使用有效期一年，即自 2024 年 9 月 30 日至 2025 年 9 月 29 日使用有效。

以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。



# 深圳至正高分子材料股份有限公司拟通过重大资产置 换、发行股份及支付现金的方式购买股权所涉及的 Advanced Assembly Materials International Limited 股东全部权益价值 资产评估报告

中联沪评字[2025]第 8 号

深圳至正高分子材料股份有限公司：

中联资产评估咨询（上海）有限公司接受贵公司的委托，按照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，采用资产基础法和市场法，按照必要的评估程序，就深圳至正高分子材料股份有限公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式购买 Advanced Assembly Materials International Limited（以下简称“AMMI”）股权之经济行为，对所涉及的 AAMI 股东全部权益在评估基准日 2024 年 9 月 30 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：

## 一、 委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人

本次资产评估的委托人为深圳至正高分子材料股份有限公司，被评估单位为 Advanced Assembly Materials International Limited。

### （一） 委托人概况

名称：深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“至正股份”）

类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所：深圳市南山区沙河街道光华街社区恩平街 1 号东部工业区 E4



法定代表人：施君

注册资金：7453.4998 万人民币

成立日期：2004-12-27

营业期限：2004-12-27 至 无固定期限

社会信用代码：91310000770201458T

经营范围：生产低烟无卤阻燃（HFFR）热塑性化合物和辐照交联化合物以及其他工程塑料、塑料合金、绝缘塑料，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件零售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## （二）被评估单位概况

### 1. 企业基本情况

企业名称：Advanced Assembly Materials International Limited（以下简称“AAMI”）

商业登记编号：71995947

类型：私人公司

住所：UNIT 311-312, BUILDING 10W, HONG KONG SCIENCE PARK, SHATIN, HONG KONG

成立日期：2020年6月24日

注册地：中国香港

主营业务：提供有关引线框架产品业务的销售和服务

### 2. 历史沿革及股东结构

2020年，ASMPT将其引线框架的设计、研发、生产与销售等相关



业务剥离至 AAMI。为此，ASMPT 于 2020 年 9 月至 12 月期间，将其下属企业持有的 AMC、ETL、AMM、AMSG 的全部股权和相关资产及负债向 AAMI 进行转让；AAMI 及/或其控制主体于 2020 年 10 月新设下属企业 AMP 及 AMB，于 2021 年 2 月新设下属企业 AMA。AAMI 设立至今的历史沿革如下：

(1) 2020 年 6 月，先进半导体材料香港有限公司设立

2020 年 6 月 24 日，先进半导体材料香港有限公司 向香港公司注册处提交法团成立表格。

2020 年 6 月 24 日，先进半导体材料香港有限公司召开董事会，同意先进半导体材料香港有限公司设立。

同日，香港公司注册处为先进半导体材料香港有限公司颁发了公司注册证书。

设立完成后，先进半导体材料香港有限公司的股权结构如下：

表1 AAMI 设立时的股权结构

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	先进科技亚洲有限公司	1	100.00

(2) 2020 年 9 月，AAMI 第一次增资

2020 年 9 月 30 日，AAMI 召开董事会，同意先进科技亚洲有限公司认购 AAMI 29 股普通股。

2020 年 10 月 15 日，AAMI 向香港公司注册处提交了股份配发申报书。

本次增资完成后，AAMI 的股权结构如下：

表2 AAMI 第一次增资后的股权结构

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	先进科技亚洲有限公司	30	100.00

(3) 2020 年 9 月，AAMI 第二次增资



2020年9月30日，AAMI召开董事会，同意先进科技亚洲有限公司认购AAMI 4,133股普通股。

2020年10月27日，AAMI向香港公司注册处提交了股份配发申报书。

本次增资完成后，AAMI的股权结构如下：

表3 AAMI 第二次增资后的股权结构

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	先进科技亚洲有限公司	4,163	100.00

（4）2020年12月，AAMI第三次增资

2020年12月28日，AAMI召开董事会，同意先进科技亚洲有限公司认购AAMI 281股普通股。

2021年1月12日，AAMI向香港公司注册处提交了股份配发申报书。

本次增资完成后，AAMI的股权结构如下：

表4 AAMI 第三次增资后的股权结构

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	先进科技亚洲有限公司	4,444	100.00

（5）2020年12月，AAMI第四次增资

2020年12月28日，AAMI召开董事会、股东会，同意香港智信以4,900万美元的价格认购AAMI 1,361股普通股；滁州智合以15,100万美元的价格认购AAMI 4,195股普通股。

同日，AAMI、先进科技亚洲有限公司、滁州智合及香港智信签署《股东协议》，AAMI全体股东约定AAMI股份将根据2021年至2023年（首尾两年包含在内）的平均调整后息税前利润（Average Adjusted EBIT）进行调整：如2021年至2023年的Average Adjusted EBIT达到22,600,000美元（“约定金额”）或以上，则AAMI应以总对价1美元



向先进科技亚洲有限公司增发相应股份；如 2021 年至 2023 年的 Average Adjusted EBIT 未达到 22,600,000 美元，则 AAMI 应以 1 美元对价向香港智信、滁州智合增发股份；前述股份增发完成后，先进科技亚洲有限公司持有 AAMI 股份比例不应超过 49%。

2021 年 1 月 12 日，AAMI 向香港公司注册处提交了本次股份配发申报书。

本次增资完成后，AAMI 的股权结构如下：

表5 AAMI 第四次增资后的股权结构

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	先进科技亚洲有限公司	4,444	44.44
2	滁州智合	4,195	41.95
3	香港智信	1,361	13.61
	合计	10,000	100.00

（6）2024 年 5 月，AAMI 第五次增资

根据 AAMI、先进科技亚洲有限公司、滁州智合及香港智信签署的《股东协议》，因 AAMI 2021 年至 2023 年的平均调整后息税前利润（Average Adjusted EBIT）超过约定金额，故 AAMI 以 1 美元对价向 ASMPT Holding 增发 894 股普通股。

2024 年 5 月 16 日，AAMI 召开董事会、股东会，同意因《股东协议》约定的股份调整条件已满足，ASMPT Holding 以 1 美元价格认购 AAMI 894 股普通股。

2024 年 6 月 13 日，AAMI 向香港公司注册处提交了股份配发申报书。

本次增资完成后，AAMI 的股权结构如下：

表6 AAMI 第五次增资后的股权结构

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	ASMPT Holding	5,338	49.00
2	滁州智合	4,195	38.51



序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
3	香港智信	1,361	12.49
	合计	10,894	100.00

### 3. 资产、财务及经营状况

#### (1)合并口径报表财务状况

截至评估基准日 2024 年 9 月 30 日, Advanced Assembly Materials International Limited 合并报表资产总额 394,997.17 万元, 负债 98,403.40 万元, 归属于母公司的所有者权益 296,593.77 万元; 2024 年 1-9 月合并报表口径营业收入 182,387.37 万元, 净利润 3,659.08 万元。

#### (2)母公司报表财务状况

截至评估基准日 2024 年 9 月 30 日, Advanced Assembly Materials International Limited 母公司报表资产总额 754,695.23 万元, 负债 514,889.49 万元, 所有者权益 239,805.74 万元; 2024 年 1-9 月母公司报表营业收入 177,150.00 万元, 净利润 3,295.93 万元。

Advanced Assembly Materials International Limited 近年资产、财务状况如下表:

表7 合并口径报表资产、负债及财务状况

金额单位: 人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
总资产	392,955.20	377,992.39	394,997.17
负债	96,824.32	75,712.37	98,403.40
净资产	296,130.88	302,280.02	296,593.77
项目	2022 年度	2023 年度	2024 年 1-9 月
营业收入	313,022.72	220,530.39	182,387.37
利润总额	39,336.58	6,206.06	3,916.19
净利润	31,469.98	2,017.77	3,659.08
审计机构	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)		

表8 母公司报表资产、负债及财务状况

金额单位: 人民币万元



项目	2022年12月31日	2023年12月31日	2024年9月30日
总资产	582,712.78	665,392.01	754,695.23
负债	343,787.38	419,320.24	514,889.49
净资产	238,925.40	246,071.77	239,805.74
项目	2022年度	2023年度	2024年1-9月
营业收入	303,890.85	208,882.29	177,150.00
利润总额	44,730.02	2,005.01	3,319.51
净利润	37,404.15	2,417.79	3,295.93
审计机构	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)		

#### 4. 股权投资情况

AAMI 母公司长期股权投资共 6 项，截至评估基准日账面原值为 1,467,975,899.29 元，未计提减值准备。AAMI 合并层面共 7 家全资控股子公司，具体情况如下：

表9 长期股权投资一览表

金额单位：人民币元

序号	子公司名称	简称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	母公司的持股比例(%)		母公司报表账面值(单位：人民币元)
							直接	间接	
1	先进半导体材料(安徽)有限公司	AMA	中国	160,000,000 美元	中国	生产导线架	100.00	-	1,121,109,915.79
2	先进半导体材料(深圳)有限公司	AMC	中国	47,835,000 美元	中国	生产导线架	100.00	-	343,263,801.97
3	Advanced Assembly Materials (M) Sdn. Bhd.	AMM	马来西亚	500,000RM	马来西亚	生产导线架	100.00	-	861,013.97
4	Advanced Assembly Materials Singapore Pte. Ltd.	AMSG	新加坡	1SGD	新加坡	销售导线架	100.00	-	309,717.64
4-1	Advanced Assembly Materials Philippines, Inc.	AMP	菲律宾	10,000,000PHP	菲律宾	销售办事处	-	100.00	-
4-2	Advanced Assembly Materials Bangkok Co.,Ltd.	AMB	泰国	6,050,000THB	泰国	销售办事处	25.05	74.95	330,838.51
5	进峰贸易(深圳)有限公司	ETL	中国	30,310,000 美元	中国	销售导线架	100.00	-	2,100,611.42

#### (1)被投资单位简介

##### 1) 先进半导体材料（安徽）有限公司（以下简称“AMA”）

企业名称：先进半导体材料（安徽）有限公司



类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

住所：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区文忠路 288 号

法定代表人：雷国辉

注册资本：16000.0000 万美元

成立日期：2021 年 2 月 9 日

营业期限：2021 年 2 月 9 日-无固定期限

统一社会信用代码：91341100MA2WP6YL0X

经营范围：设计、开发、生产、销售半导体专用材料、电子专用设备  
及零部件;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术  
进出口除外)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施(负面清  
单)).(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至评估基准日 2024 年 9 月 30 日, AMA 报表资产总额 98,383.03  
万元, 负债 19,451.97 万元, 净资产 78,931.06 万元; 2024 年 1-9 月报表  
营业收入 8,237.89 万元, 净利润-6,532.43 万元。

AMA 近年资产、财务状况如下表:

表10 AMA 报表资产、负债及财务状况

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
总资产	93,296.39	89,424.96	98,383.03
负债	19,481.73	13,461.21	19,451.97
净资产	73,814.66	75,963.75	78,931.06
项目	2022 年度	2023 年度	2024 年 1-9 月
营业收入	4,354.40	4,767.65	8,237.89
净利润	-10,267.68	-8,971.78	-6,532.43
单位	人民币万元	人民币万元	人民币万元
审计机构	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)		

2) 先进半导体材料(深圳)有限公司(以下简称“AMC”)

企业名称：先进半导体材料(深圳)有限公司

类型：有限责任公司(台港澳法人独资)



住所：深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥二区厂房 6101-6301、  
10 栋 1 楼、12-14 栋、15 栋 2-3 楼

法定代表人：雷国辉

注册资本：4783.5000 万美元

成立日期：2002 年 6 月 5 日

营业期限：无固定期限

统一社会信用代码：914403007362812201

经营范围：一般经营项目是：从事货物、技术进出口业务(不含分销、  
国家专营专控商品);房屋租赁;企业管理服务。(以上均不涉及外商投资准  
入特别管理措施项目,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项  
目是：设计、开发、生产经营半导体专用材料、电子专用工模具;电子专  
用设备及零部件生产

截至评估基准日 2024 年 9 月 30 日,AMC 报表资产总额 129,193.42  
万元,负债 25,857.47 万元,净资产 103,335.95 万元;2024 年 1-9 月报  
表营业收入 112,140.72 万元,净利润 3,536.25 万元。

AMC 近年资产、财务状况如下表:

表11 AMC 报表资产、负债及财务状况

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日	
总资产	122,559.37	122,608.28	129,193.42	143,262.58
负债	26,312.71	22,289.88	25,857.47	28,673.35
净资产	96,246.65	100,318.40	103,335.95	114,589.23
项目	2022 年度	2023 年度	2024 年 1-9 月	
营业收入	167,381.25	137,858.05	112,140.72	123,291.55
净利润	4,538.57	2,657.96	3,536.25	3,887.88
单位	人民币万元	人民币万元	人民币万元	港币万元
审计机构	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)			

3) Advanced Assembly Materials (M) SDN. BHD(以下简称“AMM”)

企业名称：Advanced Assembly Materials (M) SDN. BHD



成立日期：2020-06-17

商业登记号码：202001014538（1370858-M）

主要经营地址：PLO 534, Blok 1 & Blok 2, Jalan Keluli 3, Kawasan Perindustrian Pasir Gudang, 81700 Pasir Gudang, Johor

公司类型：股份有限公司

注册地：马来西亚

主营业务：微电子/半导体行业引线框架（衬底）和先进封装材料的设计和制造

截至评估基准日 2024 年 9 月 30 日，AMM 报表资产总额 39,110.86 万元，负债 31,362.12 万元，净资产 7,748.74 万元；2024 年 1-9 月报表营业收入 31,672.02 万元，净利润 1,547.15 万元。

AMM 近年资产、财务状况如下表：

表12 AMM 报表资产、负债及财务状况

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日	
总资产	40,969.82	42,849.18	39,110.86	5,585.54
负债	36,066.45	36,559.90	31,362.12	4,478.92
净资产	4,903.37	6,289.29	7,748.74	1,106.62
项目	2022 年度	2023 年度	2024 年 1-9 月	
营业收入	51,639.29	35,511.35	31,672.02	4,458.37
净利润	2,244.29	1,299.98	1,547.15	217.79
单位	人民币万元	人民币万元	人民币万元	美元万元
审计机构	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）			

4) Advanced Assembly Materials Singapore Pte. Ltd.（以下简称“AMSG”）

企业名称：Advanced Assembly Materials Singapore Pte. Ltd.

商业登记号码：201923043E

成立日期：2019-07-16

主要经营地址：6 Woodlands Square, #08-04 Woods Square Tower 2,



## Singapore

注册资本：1 新加坡元

公司类型：私人有限公司

注册地：新加坡

主营业务：半导体材料（引线框架）的贸易和营销

截至评估基准日 2024 年 9 月 30 日，AMSG 报表资产总额 25,631.46 万元，负债 14,981.20 万元，净资产 10,650.25 万元；2024 年 1-9 月报表营业收入 70,182.50 万元，净利润 1,391.40 万元。

AMSG 近年资产、财务状况如下表：

表13 AMSG 报表资产、负债及财务状况

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日	
总资产	47,299.83	18,305.47	25,631.46	28,422.72
负债	39,666.30	8,928.41	14,981.20	16,612.65
净资产	7,633.53	9,377.06	10,650.25	11,810.07
项目	2022 年度	2023 年度	2024 年 1-9 月	
营业收入	170,579.09	108,250.84	70,182.50	77,161.17
净利润	2,271.55	1,611.55	1,391.40	1,529.76
单位	人民币万元	人民币万元	人民币万元	港币万元
审计机构	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）			

5) Advanced Assembly Materials Philippines, Inc.（以下简称“AMP”）

企业名称：Advanced Assembly Materials Philippines, Inc.

商业登记号码：CS2020100003070-00

成立日期：2020-10-20

主要经营地址：7th Floor JD Tower, Commerce Avenue, Madrigal Business Park, Ayala Alabang, 1780 City of Muntinlupa, Fourth District, Metro Manila, Philippines

已发行股份数量：200,000 股

公司类型：有限公司

注册地：菲律宾



主营业务：销售半导体材料、电子包装材料

截至评估基准日 2024 年 9 月 30 日，AMP 报表资产总额 204.45 万元，负债 55.03 万元，净资产 149.42 万元；2024 年 1-9 月报表营业收入 102.40 万元，净利润 12.86 万元。

AMP 近年资产、财务状况如下表：

表14 AMP 报表资产、负债及财务状况

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日	
总资产	194.02	200.71	204.45	226.72
负债	46.74	63.35	55.03	61.02
净资产	147.28	137.37	149.42	165.70
项目	2022 年度	2023 年度	2024 年 1-9 月	
营业收入	88.36	126.73	102.40	112.58
净利润	7.13	-5.84	12.86	14.13
单位	人民币万元	人民币万元	人民币万元	港币万元
审计机构	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）			

6) Advanced Assembly Materials Bangkok Co.,Ltd. （以下简称“AMB”）

企业名称：Advanced Assembly Materials Bangkok Co.,Ltd.

商业登记号码：0105563155535

成立日期：2020-10-20

主要经营地址：98/23 Chueam Samphan Rd., Lam Phak Chi, Nong Chong, Bangkok 10530 Thailand

已发行股份数量：1,210,000 股

公司类型：私人有限责任公司

注册地：泰国

主营业务：销售半导体材料、电子包装材料

截至评估基准日 2024 年 9 月 30 日，AMB 报表资产总额 174.03 万元，负债 73.07 万元，净资产 100.96 万元；2024 年 1-9 月报表营业收入



113.57 万港币，净利润 12.55 万元。

AMB 近年资产、财务状况如下表：

表15 AMB 报表资产、负债及财务状况

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日	
总资产	156.00	158.40	174.03	192.99
负债	79.26	74.87	73.07	81.03
净资产	76.74	83.53	100.96	111.96
项目	2022 年度	2023 年度	2024 年 1-9 月	
营业收入	168.36	169.02	113.57	124.86
净利润	13.04	5.08	12.55	13.80
单位	人民币万元	人民币万元	人民币万元	港币万元
审计机构	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）			

7) 进峰贸易(深圳)有限公司（以下简称：“进峰贸易”）

企业名称：进峰贸易(深圳)有限公司

类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

住所：深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥二区厂房 15301-5 室

法定代表人：孔祥宇

注册资本：3031.0000 万美元

成立日期：2003-12-11

营业期限：2003-12-11 至 2033-12-11

统一社会信用代码：91440300755658783G

经营范围：一般经营项目是：(一)在国家允许外商投资的领域依法进行投资；(二)受其所投资企业的书面委托，向其所投资企业提供下列服务：1.协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2.在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3.为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4.协



助其所投资企业寻求贷款及提供担保;(三)在中国境内设立科研开发中心或部门,从事新产品及高新技术的研究开发,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务;(四)为其投资者提供咨询服务,为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务;(五)承接其母公司和关联公司的服务外包业务;(六)电子元器件、半导体材料、机器设备及相关零配件的批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请).(以上均不涉及外商投资准入特别管理措施项目,特别管理措施项目范围内投资须经审批).

截至评估基准日 2024 年 9 月 30 日, ETL 报表资产总额 26,826.10 万元, 负债 14,575.52 万元, 净资产 12,250.58 万元; 2024 年 1-9 月报表营业收入 31,724.57 万元, 净利润 521.04 万元。

ETL 近年资产、财务状况如下表:

表16 ETL 报表资产、负债及财务状况

单位: 人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
总资产	14,133.40	17,743.84	26,826.10
负债	2,906.61	6,016.11	14,575.52
净资产	11,226.79	11,727.73	12,250.58
项目	2022 年度	2023 年度	2024 年 1-9 月
营业收入	35,758.82	26,825.11	31,724.57
净利润	423.63	456.69	521.04
单位	人民币万元	人民币万元	人民币万元
审计机构	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)		

## 5. 核心业务情况

先进封装材料国际有限公司(AAMI)是全球领先的引线框架供应商, 致力为半导体封装行业提供全面的引线框架产品和材料解决方案。前身是港股上市公司 ASMPT 的物料分部业务单位, 1980 年开始运营。于 2020 年, ASMPT 与智路资本达成战略合作伙伴协议, 翌年 AAMI 以



一家独立运营的合资公司开始运作。AAMI 的总部位于中国香港，在中国深圳、中国安徽和马来西亚柔佛均设有生产基地；同时也在深圳、曼谷、菲律宾等地设立了销售公司或办事处。AAMI 引线框架覆盖不同的终端应用领域，包括计算、通信、消费者、工业、汽车等。AAMI 拥有多项专利技术，如表面粗糙化技术、氧化棕色处理（BOT）和第二代微蚀刻技术（ME-2）等，能达到 MSL1 封装可靠性的标准。AAMI 研发及推出 100x300mm 高密度引线框架的供应商，结合 ASM 的封装技术和设备，可提供一站式解决方案。

## 6. 公司执行的主要会计政策

被评估单位为香港设立的公司法人，根据《香港财务报告准则》及《香港公司条例》编报其法定财务报告。就本次评估对应的经济行为，管理层根据中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定编制合并口径及母公司单体口径财务报表，主要依据的会计政策包括财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》（财政部令 33 号，2014 年 7 月修订版）及《企业会计准则第 1 号-存货》等 41 项具体准则。

被评估单位主要主要税种及税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额	13%
企业所得税	应纳税所得额	16.5% - 25%
城市维护建设税	已交增值税额	7%
教育费附加	已交增值税额	3%
地方教育费附加	已交增值税额	2%
商品及服务税（商品及服务税系本集团位于新加坡的子公司向当地政府缴纳的税种）	当期销售货物税抵减采购货物和劳务税后的余额	2022 年 7%；2023 年 8%；2024 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 9%
马来西亚进口服务税	进口服务金额	2024 年 2 月及之前 6% 2024 年 3 月及之后 8%

其中，存在不同企业所得税税率纳税主体的情况如下：



纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司	16.5
中国内地子公司	25
新加坡子公司	17
马来西亚子公司	24
泰国子公司	20
菲律宾子公司	20

### (三) 委托人与被评估单位之间的关系

本次资产评估的委托人深圳至正高分子材料股份有限公司，被评估单位为 Advanced Assembly Materials International Limited。委托人深圳至正高分子材料股份有限公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得 Advanced Assembly Materials International Limited 的股权。

### (四) 评估报告的使用人

本评估报告的使用者为委托人以及与本次经济行为相关各方。

除国家法律法规另有规定外，任何未经评估机构和委托人确认的机构或个人不能由于得到评估报告而成为评估报告使用者。

## 二、 评估目的

根据《深圳至正高分子材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》，深圳至正高分子材料股份有限公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式购买 Advanced Assembly Materials International Limited 股权。

本次资产评估的目的是反映 AAMI 股东全部权益于评估基准日的市场价值，为上述经济行为提供价值参考。



### 三、 评估对象和评估范围

评估对象是 Advanced Assembly Materials International Limited（中文名称：先进封装材料国际有限公司，简称：“AAMI”）股东全部权益。评估范围为 Advanced Assembly Materials International Limited 全部资产及相关负债。截至评估基准日 2024 年 9 月 30 日，Advanced Assembly Materials International Limited 合并报表资产总额 394,997.17 万元，负债 98,403.40 万元，归属于母公司的所有者权益 296,593.77 万元；2024 年 1-9 月合并报表口径营业收入 182,387.37 万元，净利润 3,659.08 万元。其中流动资产 218,433.95 万元，非流动资产 176,563.22 万元；流动负债 78,723.71 万元，非流动负债 19,679.68 万元。

母公司报表资产总额 754,695.23 万元，负债 514,889.49 万元，所有者权益 239,805.74 万元；2024 年 1-9 月母公司报表营业收入 177,150.00 万元，净利润 3,295.93 万元。其中流动资产 557,188.60 万元，非流动资产 197,506.63 万元；流动负债 509,151.16 万元，非流动负债 5,738.33 万元。

上述资产与负债数据摘自经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计的 2024 年 9 月 30 日的 Advanced Assembly Materials International Limited 资产负债表，评估是在企业经过审计后的基础上进行的。

委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致。

#### （一）主要资产情况

本次评估范围内合并口径的主要资产为流动资产、固定资产、在建工程、长期股权投资、使用权资产、无形资产、商誉等。流动资产主要为公司经营过程中所形成的货币资金、应收类款项、存货等；合并口径下的长期股权投资单位为 7 家全资控股子公司；无形资产包括土地、技



术类无形资产、商标、客户关系等。

纳入评估范围内合并口径的实物资产账面值 144,555.53 万元，占评估范围内总资产的 36.60%，主要为存货、固定资产、在建工程。这些资产具有以下特点：

### 1. 实物资产分布情况和存放地点

实物资产主要分布在位于中国香港的办公场所及位于深圳、安徽滁州、马来西亚柔佛的生产场所。

### 2. 实物资产的使用现状、技术特点、大修及改扩建情况

#### (1) 存货

存货包含原材料、产成品（库存商品）、在产品（自制半成品）。原材料主要为铜卷、贵金属金银钯等，均为近期购置，保存状况良好。产成品为引线框架及模具，为被评估单位自制并对外销售的产品，保存状况良好。在产品（自制半成品）为生产过程中的引线框架半成品，保存状况良好。

#### (2) 房屋建筑物类资产

纳入本次评估范围的房屋建筑物资产为全资控股子公司先进半导体材料（安徽）有限公司申报的全部房屋建筑物资产，共有房屋建筑物 9 项，构筑物 39 项，位于企业安徽滁州的生产场所内，基准日物理状况良好，正常使用。具体明细如下表所示：

表17 房屋建筑物明细表

金额单位：人民币万元

序号	建筑物名称	权证编号	坐落	建成年月	面积 (m <sup>2</sup> )	账面价值	
						原值	净值
1	厂房	皖 (2023) 滁州市不动产权第 0027154 号	文忠路 288 号厂 房 1 等 10 户	2022/4/1	47,991.20	251,303,770.64	235,597,285.00
2	办公楼			2022/7/1	4,743.64	28,912,654.00	27,286,318.00
3	纯废水站楼			2022/4/1	9,209.63	40,700,011.11	38,156,261.00
4	门卫 1			2022/4/1	293.43	1,180,980.85	1,107,169.00
5	门卫 2			2022/4/1	82.48	365,748.71	342,889.00



序号	建筑物名称	权证编号	坐落	建成年月	面积 (m <sup>2</sup> )	账面价值	
						原值	净值
6	固废站楼			2022/4/1	1,118.80	2,647,038.10	2,481,598.00
7	化学品库房			2022/4/1	401.64	2,589,471.00	2,427,628.00
8	动力站房			2022/4/1	4,273.27	42,108,101.96	39,476,345.00
9	连廊 2			2022/7/1	164.97	1,338,048.03	1,262,783.00
合计					68,279.06	371,145,824.40	348,138,276.00

表18 构筑物明细表

金额单位：人民币万元

序号	建筑物名称	结构	建成年月	账面价值	
				原值	净值
1	泛亚#围墙#PUR_2022_020	混合	2022/8/1	431,192.66	337,768.00
2	企业 LOGO 发光字	混合	2022/9/1	199,482.53	60,953.00
3	厂区内部分护栏	钢混	2023/3/30	319,568.24	268,970.00
4	化学品库斜坡及加药区路面硬化工程	混合	2023/4/1	91,608.17	45,804.00
5	室外工程	混合	2022/8/1	19,864,535.82	18,788,541.00
6	管廊 1	重型 钢结构	2022/4/1	2,453,451.51	2,300,111.00
7	管廊 2	重型 钢结构	2022/10/10	2,472,016.36	2,317,516.00
8	喷泉水景	混合	2022/8/3	154,128.44	120,733.00
9	动力站地面环氧地坪	混合	2024/6/4	173,394.49	62,615.00
10	无锡同丰*绿化	混合	2022/8/1	1,994,328.88	1,591,520.00
11	春天园林#草坪	混合	2022/8/1	135,674.42	106,278.00
12	室外管道保温工程	混合	2023/2/1	151,376.15	67,278.00
13	厂房三楼收片区传递窗工程	混合	2023/2/1	16,956.00	7,536.00
14	厂房、化学品库房检修通道	混合	2023/2/1	62,385.32	27,727.00
15	厂房三楼 AME 线体彩钢板隔间工程	混合	2023/2/1	71,136.68	31,616.00
16	厂房茶水间工程	混合	2023/1/1	104,130.36	43,388.00
17	厂房 2#、3#提升机外门改造工程	混合	2023/10/1	68,632.92	45,756.00
18	提升机 1F 斜坡改造增补工程	混合	2023/10/1	6,422.02	4,281.00
19	九竹#东门伸缩门	混合	2023/4/1	33,398.23	16,699.00
20	厂房 3F 酸碱水洗房水池	混合	2024/1/1	38,663.40	28,998.00



序号	建筑物名称	结构	建成年月	账面价值	
				原值	净值
21	二期草地平整改善工程	混合	2024/2/1	112,752.29	87,696.00
22	同丰#厂房 1F 冲压生产区域新增隔墙改造工程	混合	2023/10/1	105,504.59	70,337.00
23	微度#厂房蚀刻预清洗区地面改善工程	混合	2023/10/1	6,961.47	4,930.00
24	播种二期草籽	混合	2024/1/1	39,689.91	29,767.00
25	微度#厂房冲压预清洗区地面改善工程	混合	2023/10/1	222,933.94	146,846.00
26	纯水站外排水利用及喷管改造工程	混合	2024/1/1	91,743.12	68,807.00
27	北二门遮阳棚	轻钢结构	2024/1/1	49,048.20	36,786.00
28	厂房电镀收片房洁净区改造工程	混合	2023/11/1	91,743.12	63,710.00
29	厂房蚀刻收片房洁净区改造工程	混合	2023/11/1	72,481.68	50,335.00
30	模具车间空调管路改造	混合	2024/1/1	54,108.00	40,581.00
31	办公室二楼新风改造工程	混合	2024/2/1	202,448.37	157,460.00
32	冲压预留区聚氨酯超耐磨地面工程	混合	2024/2/1	66,055.05	51,376.00
33	美埃#电镀空调风口改善	混合	2024/3/1	60,176.99	48,476.00
34	南京海之欣#电镀空调风口改善	混合	2024/3/1	61,371.93	49,439.00
35	美埃#蚀刻空调风口改善	混合	2024/3/1	12,460.18	10,037.00
36	南京海之欣#蚀刻空调风口改善	混合	2024/3/1	16,010.07	12,897.00
37	厂房 3F 电镀防腐环氧地面	混合	2024/6/1	365,510.84	324,899.00
38	旭隆*蒸汽排放口加围栏	混合	2024/9/1	20,180.88	19,620.00
39	轩淼*厂房屋面新增废气塔地面围堰及防腐工程	混合	2024/9/1	88,073.39	85,627.00
合计				30,581,736.62	27,633,714.00

### (3)设备类资产

此次委估的设备类资产为机器设备、电子设备、车辆，全部为被评估单位日常生产经营中使用的设备，物理状况良好，正常使用。设备类资产主要分布在 AAMI 位于中国香港、新加坡等的经营办公场所及位于深圳、安徽滁州、马来西亚柔佛的生产场所。其中，机器设备主要包括蚀刻机、冲压机、高压供配电、废水处理系统、JOS IT 系统等；电子设备主要包括电脑、打印机、水质在线分析仪等；车辆为企业日常经营中



使用的车辆。

#### (4)在建工程

此次委估的在建工程包括土建工程及设备安装工程，其中土建工程主要为位于安徽滁州的科技馆、地面 PP 板改造等，设备安装工程为位于中国香港、深圳、滁州、马来西亚等地的待安装机器设备、电子设备，截至评估基准日，均为正常安装状态，安装进度与企业规划一致。

### (二) 企业申报的账面记录或者未记录的无形资产情况

截至评估基准日，被评估单位合并口径无形资产账面原值 50,733.98 万元，累计摊销 15,413.25 万元，账面价值 35,320.73 万元。账面记录或者未记录的无形资产具体情况如下：

#### 1. 土地使用权资产

截至评估基准日，被评估单位合并口径申报评估的土地使用权资产共 1 宗，面积为 120,685 平方米，位于安徽滁州柳州路以东、福州路以西，证载权利人为被评估单位全资子公司先进半导体材料（安徽）有限公司，具体明细如下：

表19 土地使用权明细

单位：人民币元

序号	宗地名称	土地位置	实际面积(m <sup>2</sup> )	取得日期	权证编号	权利性质	证载或批文用途	原始入账价值	申报账面值
1	柳州路与文忠路交叉口东南侧	安徽省滁州市苏滁高新区文忠路288号	120,685.00	2021/3/17	皖 2023 滁州市不动产权第 0027154 号	出让	工业用地	21,270,600.00	19,787,422.72

截至评估基准日，企业申报评估的范围内除上述土地使用权资产外，未发现其他账面记录或未记录的土地使用权资产。

#### 2. 客户关系

截至评估基准日，被评估单位合并口径申报评估的客户关系类资产



为母公司 AAMI 账面记录的客户关系，被评估单位 AAMI 从 ASMPT 分拆时，对可辨认资产进行了识别并经评估确认了其公允价值，后续于收益年限相应期限内进行摊销。具体明细如下：

表20 客户关系明细

单位：人民币元

序号	内容或名称	取得日期	原始入账价值	账面价值
1	客户关系-前 10 大客户	2020/12/1	279,498,390.48	208,465,641.89
2	客户关系-20~50 大客户	2020/12/1	169,459,378.39	105,036,805.94
合计			448,957,768.87	313,502,447.83

注：原始入账价值按评估基准日 2024 年 9 月 30 日汇率换算为人民币

### 3. 专利权资产：

截至评估基准日，被评估单位合并口径申报评估的专利权资产为 AAMI 合并口径记录或未记录的专利权资产，共计 84 项。其中，账面记录的专利权资产原始入账价值 3,711.15 万元，账面价值 1,991.75 万元。

账面记录或未记录的专利权资产具体明细如下表所示：

表21 专利权资产明细

序号	专利权人	专利种类	专利名称	专利编号	申请日期	到期日
1	先进半导体材料（安徽）有限公司	发明专利	刻蚀仿真方法	2022109171575	2022/8/1	2042/7/31
2	先进半导体材料（安徽）有限公司	发明专利	刻蚀仿真模型的构建方法	2022109254455	2022/8/1	2042/7/31
3	先进半导体材料（安徽）有限公司	发明专利	电镀装置	2022106736193	2022/6/13	2042/6/12
4	先进半导体材料（安徽）有限公司	发明专利	包括掺杂的银层的镀覆的引线框架	2017104505653	2017/6/15	2037/6/14
5	先进半导体材料（安徽）有限公司	发明专利	引线框的微爆处理方法	2009102240668	2009/12/3	2029/12/2
6	先进半导体材料（安徽）有限公司	发明专利	冲压式引线框及其制造方法	2007101475099	2007/8/23	2027/8/22
7	先进半导体材料（安徽）有限公司	发明专利	包含镀锡或由其形成金属间化合层的引线框及其制造方法	2006101452938	2006/11/29	2026/11/28
8	先进半导体材料（安徽）有限公司	发明专利	用于增强半导体器件模塑料的粘着的涂覆	2005101319655	2005/12/22	2025/12/21
9	先进半导体材料（安徽）有限公司	发明专利	电镀方法	TWI852310B	2023/8/13	2043/1/17
10	先进半导体材料	发明	电镀装置	TWI854460	2023/1/18	2043/1/17



	(安徽)有限公司	专利				
11	先进半导体材料 (安徽)有限公司	实用新型	引线框以及芯片封装产品	2023235310008	2023/12/22	2033/12/21
12	先进半导体材料 (安徽)有限公司	实用新型	一种基于组合光源装置的图像检测系统	2023227590204	2023/10/13	2033/10/12
13	先进半导体材料 (安徽)有限公司	实用新型	引线框架	2023224341661	2023/9/7	2033/9/6
14	先进半导体材料 (安徽)有限公司	实用新型	一种表面粗化装置	2023224409486	2023/9/7	2033/9/6
15	先进半导体材料 (安徽)有限公司	实用新型	引线框与芯片封装产品	2023220002678	2023/7/27	2033/7/26
16	先进半导体材料 (安徽)有限公司	实用新型	引线框架	202320428772X	2023/3/3	2033/3/2
17	先进半导体材料 (安徽)有限公司	实用新型	一种引线框架的防弯曲装置	2023203714879	2023/2/27	2033/2/26
18	先进半导体材料 (安徽)有限公司	实用新型	一种引线框架的防弯曲装置	2023203722019	2023/2/27	2033/2/26
19	先进半导体材料 (安徽)有限公司	实用新型	晶片封装结构	2022206616055	2022/3/25	2032/3/24
20	先进半导体材料 (安徽)有限公司	实用新型	一种引线框架及芯片封装产品	2022202977660	2022/2/14	2032/2/13
21	先进半导体材料 (安徽)有限公司	实用新型	紫外曝光机的曝光装置以及紫外曝光机	2022202256648	2022/1/27	2032/1/26
22	先进半导体材料 (安徽)有限公司	实用新型	引线框架	202123426285X	2021/12/31	2031/12/30
23	先进半导体材料 (安徽)有限公司	实用新型	引线框架	2021234208573	2021/12/31	2031/12/30
24	先进半导体材料 (安徽)有限公司	实用新型	贴片机的贴片装置以及贴片机	2021232232262	2021/12/21	2031/12/20
25	先进半导体材料 (安徽)有限公司	实用新型	贴片机的预热装置以及贴片机	2021232236795	2021/12/21	2031/12/20
26	先进半导体材料 (安徽)有限公司	实用新型	贴片机的冷却装置以及贴片机	2021232236511	2021/12/21	2031/12/20
27	先进半导体材料 (安徽)有限公司	实用新型	单边夹持送检装置以及引线框架视觉终检设备	2021230057983	2021/12/2	2031/12/1
28	先进半导体材料 (安徽)有限公司	实用新型	一种引脚及引线框架	2021216602209	2021/7/20	2031/7/19
29	先进半导体材料 (安徽)有限公司	实用新型	一种引线框架及芯片封装产品	TWM644421U	2023/2/13	2033/2/12
30	先进半导体材料 (安徽)有限公司	实用新型	引线框架	TWM641737U	2022/11/30	2032/11/29
31	先进半导体材料 (安徽)有限公司	实用新型	引线框架	TWM643983U	2022/11/30	2032/11/29
32	先进半导体材料 (安徽)有限公司	实用新型	紫外曝光机的曝光装置以及紫外曝光机	TWM643982U	2022/11/30	2032/11/29
33	先进半导体材料 (深圳)有限公司	发明专利	电镀设备及电镀方法	2021102956950	2021/3/19	2041/3/18
34	先进半导体材料 (深圳)有限公司	发明专利	引线框架的瑕疵检测方法	TWI848462B	2022/12/7	2042/12/6
35	先进半导体材料 (深圳)有限公司	发明专利	封装结构的形成方法	TWI852210B	2022/12/7	2042/12/6
36	先进半导体材料	发明	引线框架的贴片机	TWI845077B	2022/12/20	2042/12/19



	(深圳)有限公司	专利				
37	先进半导体材料(深圳)有限公司	发明专利	恒压喷淋设备、恒压喷淋方法以及监控器	TWI834337B	2022/10/13	2042/10/12
38	先进半导体材料(深圳)有限公司	发明专利	引线框架的出货方法	TWI837941B	2022/11/11	2042/11/10
39	先进半导体材料(深圳)有限公司	发明专利	引线框结构	TWI834421B	2022/12/7	2042/12/6
40	先进半导体材料(深圳)有限公司	发明专利	引线框结构的形成方法	TWI831499B	2022/12/1	2042/11/30
41	先进半导体材料(深圳)有限公司	发明专利	引线框架的出货方法	TWI856420	2022/11/11	2042/11/10
42	先进半导体材料(深圳)有限公司	发明专利	封装结构	TWI856448	2022/12/7	2042/12/6
43	先进半导体材料(深圳)有限公司	实用新型	集成电路引线框架电极板及电镀装置	2021220907638	2021/8/31	2031/8/30
44	先进半导体材料(深圳)有限公司	实用新型	贴片机的预热装置以及贴片机	TWM643231U	2022/12/20	2032/12/19
45	先进半导体材料(深圳)有限公司	实用新型	贴片机的贴片装置以及贴片机	TWM646265U	2022/12/20	2032/12/19
46	先进半导体材料(深圳)有限公司	实用新型	贴片机的冷却装置以及贴片机	TWM643232U	2022/12/20	2032/12/19
47	先进半导体材料(深圳)有限公司	实用新型	一种引脚及引线框架	TWM641162U	2022/7/20	2032/7/19
48	先进半导体材料(深圳)有限公司	实用新型	单边夹持送检装置	TWM653343U	2022/12/1	2032/11/30
49	Advanced Assembly Materials International Limited	发明专利	Routable electroforming substrate comprising removable carrier	SG10201803223 YB	2018/4/18	2038/4/18
50	Advanced Assembly Materials International Limited	发明专利	A lead frame and a method of manufacturing thereof	SG2014004857B	2014/1/21	2034/1/21
51	Advanced Assembly Materials International Limited	发明专利	A lead frame and a method of fabrication thereof	SG10201605575 VB	2014/1/17	2034/1/17
52	Advanced Assembly Materials International Limited	发明专利	Leadframe comprising tin plating or an intermetallic layer formed therefrom	SG132658B	2006/11/29	2026/11/29
53	Advanced Assembly Materials International Limited	发明专利	Leadframe treatment for enhancing adhesion of encapsulant thereto	US8012886B2	2007/3/7	2028/4/1
54	Advanced Assembly Materials International Limited	发明专利	Stamped leadframe and method of manufacture thereof	US8174096B2	2006/8/25	2027/9/22
55	Advanced Assembly Materials International Limited	发明专利	Pre-plated leadframe having enhanced encapsulation adhesion	US7691679B2	2007/3/23	2027/3/23
56	Advanced Assembly Materials International	发明专利	Leadframe comprising tin plating or an intermetallic layer formed therefrom	US7462926B2	2005/12/1	2026/3/14



	Limited					
57	Advanced Assembly Materials International Limited	发明专利	Coating for enhancing adhesion of molding compound to semiconductor devices	US7329617B2	2004/12/22	2025/9/2
58	Advanced Assembly Materials International Limited	发明专利	Routable electroforming substrate comprising removable carrier	US10475666B2	2018/4/12	2038/4/12
59	Advanced Assembly Materials International Limited	发明专利	Plated lead frame including doped silver layer	US9847468B1	2016/6/20	2036/6/20
60	Advanced Assembly Materials International Limited	发明专利	Lead frame and a method of manufacturing thereof	US9202712B2	2014/1/17	2034/1/17
61	Advanced Assembly Materials International Limited	发明专利	Lead frame and a method of fabrication thereof	US9805956B2	2013/1/23	2033/4/17
62	Advanced Assembly Materials International Limited	发明专利	モールディングコンパウンドの半導体装置への付着を強化するコーティング（增强模塑料与半导体器件粘合力的涂层）	JP4402649B2	2005/12/20	2025/12/20
63	Advanced Assembly Materials International Limited	发明专利	リードフレームに対するマイクロブラスト処理（引线框架上的微喷砂）	JP5279694B2	2009/12/18	2029/12/18
64	Advanced Assembly Materials International Limited	发明专利	반도체 디바이스에 몰딩 화합물의 접착을 강화하기 위한 코팅（为增强半导体器件上模塑化合物的附着力的涂层）	KR100685160B1	2005/12/21	2025/12/21
65	Advanced Assembly Materials International Limited	发明专利	스탬핑된 리드프레임 및 그 제조 방법（冲压式主轴及其制造方法）	KR100927319B1	2007/8/24	2027/8/24
66	Advanced Assembly Materials International Limited	发明专利	Micro-Blasting Treatment for Lead Frames	KR101157412B1	2009/12/21	2029/12/21
67	Advanced Assembly Materials International Limited	发明专利	การเคลือบเพิ่มการยึดเกาะของสารประกอบเพื่อออกฤทธิ์หล่อขึ้นรูปให้กับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ（涂层增加了化合物形成半导体装置的粘附）	TH39221B	2005/12/21	2025/12/20
68	Advanced Assembly Materials International Limited	发明专利	用于增强半导体器件模塑料的粘着的涂覆	TWI295091B	2005/12/19	2025/12/18
69	Advanced Assembly Materials International Limited	发明专利	包含镀锡或由其形成金属间化合物层的引线框	TWI323031B	2006/11/24	2026/11/23
70	Advanced Assembly Materials International Limited	发明专利	冲压式引线框及其制造方法	TWI347665B	2007/8/7	2027/8/6



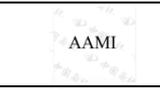
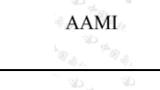
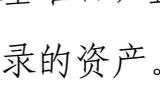
	International Limited						
71	Advanced Assembly Materials International Limited	发明专利	具有增强的灌封黏着的预镀引线框	TWI379396B	2008/3/21	2028/3/20	
72	Advanced Assembly Materials International Limited	发明专利	包括参杂的银层的镀覆的引线框架	TWI662153B	2017/6/5	2037/6/4	
73	Advanced Assembly Materials International Limited	发明专利	包含可去除载体的可布线电铸衬底	TWI664706B	2018/4/12	2038/4/11	
74	Advanced Assembly Materials International Limited	发明专利	引线框的微爆处理方法	TWI433286B	2009/11/30	2029/11/29	
75	Advanced Assembly Materials International Limited	发明专利	Coating for Enhancing Adhesion of Molding Compound to Semiconductor Devices	PH12005000610 B1	2005/12/19	2025/12/18	
76	Advanced Assembly Materials International Limited	发明专利	Leadframe Comprising Tin Plating or an Intermetallic Layer Formed Therefrom	PH12006000550 B1	2006/11/24	2026/11/23	
77	Advanced Assembly Materials International Limited	发明专利	Coating for Enhancing Adhesion of Molding Compound to Semiconductor Devices	MY151621A	2005/12/21	2025/12/21	
78	Advanced Assembly Materials International Limited	发明专利	Leadframe Comprising Tin Plating or an Intermetallic Layer Formed Therefrom	MY140407A	2006/11/28	2026/11/28	
79	Advanced Assembly Materials International Limited	发明专利	Coating for Enhancing Adhesion of Molding Compound to Semiconductor Devices	SG123736B	2005/12/16	2025/12/16	
80	Advanced Assembly Materials International Limited	发明专利	Micro-Blasting Treatment for Lead Frames	SG162685B	2009/12/10	2029/12/10	
81	Advanced Assembly Materials International Limited	发明专利	Pre-Plated Leadframe Having Enhanced Encapsulation Adhesion	MY147386A	2008/3/21	2028/3/21	
82	Advanced Assembly Materials International Limited	发明专利	Micro-Blasting Treatment for Lead Frames	MY153943A	2009/12/21	2029/12/21	
83	Advanced Assembly Materials International Limited	发明专利	引线框架及其形成方法, 芯片封装方法	2014102770400	2014/6/19	2034/6/18	
84	Advanced Assembly Materials International Limited	发明专利	Pre-Plated Leadframe Having Enhanced Encapsulation Adhesion	PH12008000098	2008/3/24	2028/3/24	



#### 4. 商标权资产

截至评估基准日，被评估单位申报评估的账面未记录的商标权资产共计 10 项，具体明细如下表所示：

表22 商标权资产明细

序号	商标注册人	商标图形	注册编号	商标类别	专用权期限	注册地
1	AAMI		58526140	9	2022-04-07 至 2032-04-06	中国大陆
2			61373301	9	2022-06-07 至 2032-06-06	中国大陆
3			58543763A	9	2021-08-17 至 2031-08-16	中国大陆
4			61376109	6	2021-08-17 至 2031-08-16	中国大陆
5			305720265	9	2022-02-16 至 2032-02-15	中国香港
6			305720274	9	2022-02-16 至 2032-02-15	中国香港
7			02202480	9	2021-08-19 至 2031-08-19	中国台湾
8			02202479	9	2021-08-19 至 2031-08-19	中国台湾
9			40202119891V	9	2022-04-07 至 2032-04-06	新加坡
10			40202119890S	9	2022-06-07 至 2032-06-06	新加坡

截至评估基准日，企业申报评估的范围内除上述无形资产，未发现其他账面未记录的资产。

#### (三) 企业申报的表外资产的类型、数量

截至评估基准日，被评估单位申报的表外资产主要为未入账的技术类无形资产、商标权资产，具体申报的专利权资产明细与数量详见前文章节。企业申报评估的范围内除上述无形资产外，未发现其他账面未记录的资产。

#### (四) 引用其他机构出具的报告的结论所涉及的资产类型、数量和



## 账面金额

本次评估报告中基准日各项资产及负债账面值系德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《先进封装材料国际有限公司审计报告》(德师报(审)字(25)第 S00067 号)审计结果。评估是在企业经过审计后的基础上进行的。

除此之外,未引用其他机构报告内容。

## 四、 价值类型

依据本次评估目的,确定本次评估的价值类型为市场价值。

市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下,评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

## 五、 评估基准日

本项目资产评估的基准日是 2024 年 9 月 30 日。

此基准日是委托人在综合考虑被评估单位的资产规模、工作量大小、预计所需时间、合规性等因素的基础上确定的。

## 六、 评估依据

本次资产评估遵循的评估依据主要包括经济行为依据、法律法规依据、评估准则依据、资产权属依据,及评定估算时采用的取价依据和其他参考资料等,具体如下:

### (一) 经济行为依据

《深圳至正高分子材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》

### (二) 法律法规依据



1. 《中华人民共和国资产评估法》(2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过);
2. 《中华人民共和国公司法》(2023年12月29日第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修订);
3. 《中华人民共和国民法典》(2020年5月28日第十三届全国人民代表大会第三次会议通过);
4. 《中华人民共和国企业所得税法》(2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过);
5. 《中华人民共和国证券法》(2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订);
6. 《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令 第 691 号, 2017 年 10 月 30 日国务院第 191 次常务会议通过);
7. 《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》(财政部国家税务总局令 第 50 号);
8. 《中华人民共和国专利法》(根据 2020 年 10 月 17 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议第四次修正);
9. 《中华人民共和国商标法》(2019 年 4 月 23 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修正);
10. 财政部、国家税务总局《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》(财税[2008]170 号);
11. 财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号);
12. 财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32 号);
13. 《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局



海关总署公告 2019 年第 39 号)；

14. 《上市公司重大资产重组管理办法（2020 年修订）》（证监会令第 166 号）；

15. 《监管规则适用指引—评估类第 1 号》中国证券监督管理委员会；

16. 其他与评估工作相关的法律、法规和规章制度等。

### （三）评估准则依据

1. 《资产评估基本准则》（财资[2017]43 号）；
2. 《资产评估职业道德准则》（中评协[2017]30 号）；
3. 《资产评估执业准则-资产评估程序》（中评协[2018]36 号）；
4. 《资产评估执业准则-资产评估方法》（中评协[2019]35 号）；
5. 《资产评估价值类型指导意见》（中评协[2017]47 号）；
6. 《资产评估执业准则-资产评估报告》（中评协[2018]35 号）；
7. 《资产评估执业准则-企业价值》（中评协[2018]38 号）；
8. 《资产评估执业准则-资产评估委托合同》（中评协[2017]33 号）；
9. 《资产评估执业准则-资产评估档案》（中评协[2018]37 号）；
10. 《资产评估机构业务质量控制指南》（中评协[2017]46 号）；
11. 《资产评估对象法律权属指导意见》（中评协[2017]48 号）；
12. 《资产评估业准则-无形资产》（中评协[2017]37 号）；
13. 《资产评估执业准则-不动产》（中评协[2017]38 号）；
14. 《资产评估执业准则-机器设备》（中评协[2017]39 号）；
15. 《知识产权资产评估指南》（中评协[2017]44 号）；
16. 《专利资产评估指导意见》（中评协[2017]49 号）。
17. 《商标资产评估指导意见》（中评协[2017]51 号）；



18. 其他与评估工作相关的准则等。

#### (四) 资产权属依据

1. 专利证书、商标等无形资产权属证明；
2. 重要资产购置合同或凭证；
3. 不动产权证；
4. 其他参考资料。

#### (五) 取价依据

1. 国家外汇管理局公布的基准日人民币基准汇价；
2. 中国人民银行公布的基准日全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率（LPR）公告；
3. 国家统计局、国家有关部门和行业协会发布的统计数据；
4. 相关上市公司公开信息资料；
5. 《2024 机电产品报价信息系统》（机械工业信息研究院）；
6. 重要业务合同、资料；
7. 其他参考资料。

#### (六) 其它参考资料

1. 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《先进封装材料国际有限公司审计报告》（德师报(审)字(25)第 S00067 号）；
2. 同花顺 Ifind 资讯金融终端；
3. CapitalIQ 数据库；
4. 《投资估价》（[美] Damodaran 著，[加] 林谦译，清华大学出版社）；
5. 《企业会计准则-基本准则》（财政部令 33 号，财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布，2014 年 7 月修订版）及《企业会计准则第 1 号-存



货》等 41 项具体准则)；

6. 《资产评估专家指引第 8 号——资产评估中的核查验证》(中评协[2019]39 号)；

7. 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、深圳证券交易所网站相关信息；

8. 其他参考资料。

## 七、 评估方法

### (一) 评估方法简介

依据《资产评估执业准则——企业价值》(中评协[2018]38 号)和《资产评估执业准则——资产评估方法》(中评协[2019]35 号)的规定,执行企业价值评估业务,应当根据评估目的、评估对象、价值类型、评估方法的适用条件、评估方法应用所依据数据的质量和数量等情况,分析收益法、市场法和资产基础法三种基本方法的适用性,选择评估方法。

企业价值评估中的收益法,是指将预期收益资本化或者折现,确定评估对象价值的评估方法。资产评估专业人员应当结合企业性质、资产规模、历史经营情况、未来收益可预测情况、所获取评估资料的充分性,恰当考虑收益法的适用性。

企业价值评估中的市场法,是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较,确定评估对象价值的评估方法。资产评估专业人员应当根据所获取可比企业经营和财务数据的充分性和可靠性、可收集到的可比企业数量,考虑市场法的适用性。

企业价值评估中的资产基础法是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础,评估表内及表外可识别的各项资产、负债价值,确定评估对象价值的评估方法



## (二) 评估方法选择

深圳至正高分子材料股份有限公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式购买 Advanced Assembly Materials International Limited 股权。本次资产评估的目的是反映 AAMI 股东全部权益于评估基准日的市场价值，为上述经济行为提供价值参考。

被评估单位是一家从事半导体材料中的引线框架产品研发、生产及销售的企业，当前受外部市场和政策影响波动较大。AAMI 所处的半导体行业虽然从长周期角度看半导体行业处于周期性上行的趋势中，全球半导体行业从 2000 年代的 1000 亿美元级别上升到 2020 年代约 4000~5000 亿美金级别，但在短期内，半导体行业存在明显周期性特征，行业周期性衰退和复苏时点较难把握，管理层无法准确判断短期内的周期性趋势，行业未来恢复时期和恢复幅度具有较大不确定性，因此管理层无法准确判断短期内的周期性趋势无法可靠预计未来现金流量，因此本次评估未选择收益法进行评估。

本次评估涉及上市公司资产重组，资产基础法从企业购建角度反映了企业的价值，为经济行为实现后企业的经营管理及考核提供了依据，因此本次评估选择资产基础法进行评估。

评估基准日前后，市场上存在与被评估单位经营范围、业务规模、发展阶段相近的上市公司，因此本次评估可以选择市场法进行评估。

综上，本次评估确定采用资产基础法和市场法进行评估。

## (三) 资产基础法

资产基础法，是指以被评估单位或经营体评估基准日的资产负债表为基础，评估表内及表外可识别的各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法，具体是指将构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值求得企业价值的方法。



各类资产及负债的评估方法如下:

## 1. 流动资产

### (1) 货币资金

对于币种为人民币的货币资金,以核实后账面值确定评估值。对于外币现金,以盘点核实后的外币金额结合评估基准日外币汇率测算外币现金评估值。

### (2) 应收类款项

应收类款项包含应收账款、其他应收款。对应收类款项的评估,评估人员在了解应收类款项的存在性、完整性。并在核实无误的基础上,依据历史资料和现场尽调获得的信息,具体分析数额、欠款时间和原因、款项回收情况、欠款人资金、信用、经营管理现状等相关事项,判断应收类款项的可收回性。

分析应收类款项可回收性时,参考企业会计计算坏账准备的方法估计应收类款项的评估风险损失。即:

对关联方往来款项等有充分理由相信全部能收回的,评估风险损失的可能性为 0%;

对有确凿证据表明款项不能收回或账龄超长的,评估风险损失为 100%。

以核实后的应收类款项账面金额减去评估风险损失后的金额确定应收类款项评估值。同时,坏账准备按评估有关规定评估为零。

### (3) 预付账款

对预付账款的评估,评估人员在核实无误的基础上,依据历史资料和现场尽调获得的信息,具体分析数额、欠款时间和原因、款项回收情况、欠款人资金、信用、经营管理现状等,判断欠款人是否有破产、撤销或不能按合同约定按时提供货物、服务等情况,在未发现上述异常的



情况下，以核实后账面值作为评估值。

#### (4)原材料

经现场调查了解，企业对原材料采用实际成本核算。原材料购入日期距评估基准日较近，周转正常，不存在积压和损坏等现象，本次评估对其抽查了购置合同、发票等资料，与其账面值进行比对分析差异不大，账面价值基本反映了原材料的现行市场价值，以核实后的账面值确定评估值。

#### (5)产成品

评估人员依据调查情况和企业提供的资料分析，对于产成品以不含税销售价格减去销售费用、全部税金和一定的产品销售风险后确定评估值。

评估价值=实际数量×不含税售价×(1-产品销售税金及附加费率-销售费用率-营业利润率×所得税率-营业利润率×(1-所得税率)×r)

1)不含税售价：不含税售价是按照评估基准日前后的市场价格确定的；

2)产品销售税金及附加费率主要包括以增值税为税基计算交纳的城市建设税与教育附加；

3)销售费用率是按销售费用与销售收入的比例平均计算；

4)营业利润率=主营业务利润÷营业收入；

主营业务利润=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-研发费用-财务费用

5)所得税率按企业现实执行的税率；

6)r 为一定的率，由于产成品未来的销售存在一定的市场风险，具有一定的不确定性，根据基准日调查情况及基准日后实现销售的情况确定其风险。其中 r 对于畅销产品为 0，一般销售产品为 50%，勉强可销



售的产品为 100%。

### (6)其他流动资产

对其他流动资产的评估，核对评估明细表与报表是否相符，查阅款项金额、发生时间、业务内容等账务记录，以证实资产的真实性、完整性。在核实无误的基础上，以核实后账面值确定为评估值。

## 2. 长期股权投资

对长期股权投资，首先对长期投资形成的原因、账面值和实际状况等进行了取证核实，并查阅了投资协议、股东会决议、章程和有关会计记录等，以确定长期投资的真实性和完整性。

对于全资控股子公司，对被投资单位评估基准日的资产逐项进行了评估，然后将被投资单位评估基准日净资产评估值乘以被评估单位的持股比例计算确定评估值：

长期股权投资评估值=被投资单位整体评估后净资产评估值×持股比例

本次评估中，在确定长期股权投资评估值时，评估师没有考虑控股权和少数股权等因素产生的溢价和折价，也未考虑股权流动性对评估结果的影响。

## 3. 固定资产-设备类资产

根据本次评估目的，按照持续使用原则，以市场价格为依据，结合委估设备的特点和收集资料情况，主要采用重置成本法进行评估。对于在二手市场可询到价的旧设备，采用市场法进行评估。

评估值=重置全价×成新率

### (1) 重置全价的确定

根据当地市场信息及市场价格资料，确定评估基准日的电子设备价格，一般生产厂家或代理产提供免费运输及安装调试，不含税购置价确



定其重置全价：

重置全价（不含税）=购置价（不含税）

另：部分电子设备采用市场法进行评估。

### （2）成新率的确定

成新率=[尚可使用年限÷（已使用年限+尚可使用年限）]×100%

另：直接按二手市场价评估的电子设备，无须计算成新率。

### （3）评估值的确定

评估值=重置全价×成新率

## 4. 在建工程

此次在建工程采用重置成本法评估。为避免资产重复计价和遗漏资产价值，结合本次在建工程特点，针对各项在建工程——设备安装工程类型和具体情况，采用以下评估方法：

在建工程的合理工期较短，在建设设备重置成本及安装费变化不大，在核实在建工程账面金额无误的前提下，评估以清查核实后的账面值确定评估值。

## 5. 使用权资产

评估人员核对了企业总账、明细账、会计报表及清查评估明细表，审核了相关的原始凭证、租赁合同，对每项租赁资产的初始计量、摊销金额的准确性、合理性等进行了分析，符合租赁会计准则的核算规定，账面余额合理反映了基准日企业享有的相关使用权资产的权益价值，故本次评估以核实后账面值确认评估值。

## 6. 无形资产

### （1）技术类无形资产

专利、许可及非专利技术以收益法为基础，即以委估无形资产未来所能创造的收益的现值来确定估值，对专利、许可及非专利技术而言，



其价值主要来源于直接变卖该等无形资产的收益，或者通过使用该等无形资产为其产品或服务注入技术加成而实现的超额收益。

考虑到专利、许可及非专利技术应用在企业经营的主要业务当中所带来收益，采用收入分成法较能合理估算专利、许可及非专利技术的价值。

基本公式如下：

$$P = \sum_{i=1}^n \frac{K \cdot A_i \cdot (1-T)}{(1+r)^i}$$

式中：P——估值

K——技术分成率，即许可费率

$A_i$ ——未来第*i*年收益额

n——收益年限

r——折现率

T——所得税税率

## (2)客户关系类无形资产

参照《INTERNATIONAL VALUATION STANDARDS 2017》，对客户关系类的无形资产采用收益法进行估值。收益法考虑在企业经营的主要业务中，通过无形资产能够带来相比有形资产投入更高的收益，即采用超额收益法计算客户关系的价值。基本思路如下：（1）企业预计的收益主要由企业的营运资本、固定资产、人力资源和无形资产带来；（2）根据企业预计的各年现金流，扣减营运资本、固定资产、人力资源乘以各自预期的回报率，即为无形资产带来的超额收益；（3）按照无形资产中客户关系分成计算其超额收益，并计算的各年超额收益折现，其现值即为客户关系的价值。

客户关系估值=客户关系超额收益法价值

客户关系对应的总超额收益=客户关系对应 EBIT × (1-T) -其他经



营性资产 × 预期收益率

$$P = \sum_{i=1}^n \frac{K \times R_i}{(1+r)^i}$$

P——待估客户关系的估值；

K——客户关系对超额收益的贡献率；

R<sub>i</sub>——客户关系对应第 i 年的超额收益；

r——客户关系的折现率；

n——客户关系的收益期限；

i——客户关系的折现期；

### (3) 商标权类无形资产

依据商标权无形资产形成过程中所需投入的各种成本费用的重置价值确认商标权价值，其基本公式如下：

$$P = C_1 + C_2 + C_3$$

式中：

P：评估值

C1：设计成本

C2：注册及续延成本

C3：维护使用成本

### 7. 长期待摊费用

评估人员核对明细账与总账、报表余额是否相符，核对与委估明细表是否相符，查阅了款项金额、发生时间、业务内容等账务记录，抽查了原始入账凭证、合同等，核实其核算内容的真实性和完整性。经核实，长期待摊费用原始发生额真实、准确，摊销余额正确，长期待摊费用在未来受益期内仍可享有相应权益或资产，按尚存受益期应分摊的余额确定评估值。

### 8. 商誉



评估人员核对明细账与总账、报表余额是否相符，核对与委估明细表是否相符，抽查了原始入账凭证，核实其核算内容的真实性和完整性。经核实，商誉原始发生额真实、准确，账面价值正确，商誉余额的变动主要受外币财务报表折算差异的影响，被评估单位经营情况较好，不存在减值的情况。由于在AAMI母公司层面商誉不可单独识别，其价值来源于企业整体业务的协同效应，而非单独的资产贡献，因此商誉评估值为0元。

#### 9. 其他非流动资产

评估人员核对明细账与总账、报表余额是否相符，核对与委估明细表是否相符，查阅了款项金额、发生时间、业务内容等账务记录，抽查了原始入账凭证、合同、协议等资料，以证实其他非流动资产的真实性、完整性。在核实无误的基础上，以核实后账面值确定评估值。

#### 10. 负债

检验核实各项负债在评估目的实现后的实际债务人、负债额，以评估目的实现后的产权所有者实际需要承担的负债项目及金额确定评估值。

### (四) 市场法

#### 1. 概述

根据《资产评估执业准则—企业价值》，企业价值评估中的市场法，是指将被评估单位与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定被评估单位价值的评估方法。

##### (1) 市场法的应用前提

运用市场法评估企业价值需要满足如下基本前提条件：

1) 要有一个充分发展、活跃的、公开的市场，在这个市场上成交价格基本上反映市场买卖双方的行情，因此可以排除个别交易的偶然性。



2) 在这个公开市场上要有可比的企业及其交易活动，且交易活动应能较好反映企业价值的趋势。企业及其交易的可比性是指筛选的可比企业及其交易活动是在近期公开市场上已经发生过的，且与待评估的目标企业及其即将发生的业务活动相似。

3) 参照物与被评估单位的价值影响因素明确，可以量化，相关资料可以搜集。

## (2) 市场法选择的理由和依据

市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。

上市公司比较法是指获取并分析可比上市公司的经营和财务数据，计算价值比率，在与被评估单位比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。

交易案例比较法是指获取并分析可比企业的买卖、收购及合并案例资料，计算价值比率，在与被评估单位比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法，评估基准日前后，评估人员未能从公开市场渠道获取相同或近似的可比交易案例信息，因此本评估未采用交易案例比较法。

被评估单位所属模拟芯片设计行业，评估基准日前后，市场上存在较多与被评估单位经营范围、业务规模、发展阶段相近的上市公司，可比性较强，因此本次评估采用上市公司比较法进行评估。

## 2. 评估思路

运用市场法评估通过下列步骤进行：

### (1) 筛选可比上市公司

搜集可比上市公司信息，筛选和确定适当数量的可比上市公司。基于以下原则筛选可比上市公司：

- A. 筛选在交易市场方面相同或者可比的可比上市公司；
- B. 筛选在业务内容、经营模式、企业规模、资产配置和使用情况、



企业所处经营阶段、成长性、经营风险、财务风险等方面相同或者相似的可比上市公司；

C. 筛选交易时间与评估基准日接近的可比上市公司；

D. 筛选交易背景与评估目的相适合的可比上市公司；

E. 筛选正常或者可以修正为正常交易价格的可比上市公司。

## (2) 建立比较基准

1) 本次评估对可比上市公司交易价格进行调整，将可比上市公司包含流通性的市场交易价格调整为与被评估单位相同条件的非流通价格。

## 2) 计算价值比率

筛选适当的价值比率。价值比率通常包括盈利比率、资产比率、收入比率和其他特定比率。结合资本市场数据，对被评估单位与可比公司所处行业的价值影响因素进行线性回归分析，筛选相对合适的价值比率。

将 100% 股权价格除以可比公司价值因子，得到各价值比率。

## (3) 计算评估结果

按照业务结构、经营模式、企业规模、资产配置和使用情况、企业生命周期、成长性、经营风险、财务风险等因素筛选后的各可比公司已较高可比性，将各可比公司价值比率与被评估单位各价值因子相乘，得到评估结果。

## 3. 评估模型

本次评估的基本模型为：

目标公司股东全部权益价值 = 目标公司经营价值 EV + 货币资金 - 付息债务

目标公司经营价值 EV = 目标公司 EBITDA × 目标公司 EV/EBITDA

其中：目标公司 EV/EBITDA = 扣除流动性折扣后可比上市公司 EV/EBITDA 的算术平均值



扣除流动性折扣后可比上市公司  $EV/EBITDA = \text{可比公司 } EV / \text{可比公司 } EBITDA$

可比上市公司  $EV = \text{可比公司市值} * (1 - \text{对应市场流动性折扣比例}) + \text{少数股东权益} + \text{付息债务} - \text{货币资金}$

## 八、 评估程序实施过程和情况

整个评估工作分四个阶段进行：

### (一) 评估准备阶段

#### 1. 项目洽谈及接受项目委托

了解拟承接业务涉及的被评估单位及评估对象的基本情况，明确评估目的、评估对象及评估范围、评估基准日；根据评估目的和交易背景等具体情况对专业胜任能力、独立性和业务风险进行综合分析和评价，签署资产评估委托合同。

#### 2. 确定评估方案编制工作计划

与委托人和项目相关各方中介充分沟通，进一步确定了资产评估基本事项和被评估单位资产、经营状况后，收集被评估单位所在行业的基本政策、法律法规以及行业的市场经营情况，在此基础上拟定初步工作方案，制定评估计划。

#### 3. 提交资料清单及访谈提纲

根据委估资产特点，提交针对性的尽职调查资料清单，及资产清单、盈利预测等样表，要求被评估单位进行评估准备工作。

#### 4. 辅导填表和评估资料准备工作

与被评估单位相关工作人员联系，辅导被评估单位按照资产评估的要求准备评估所需资料及填报相关表格。

### (二) 现场评估阶段



项目组现场评估阶段的主要工作如下:

### 1. 初步了解整体情况

听取委托人及被评估单位有关人员介绍被评估单位总体情况和委估资产的历史及现状,了解被评估单位的历史沿革、财务制度、经营状况、固定资产技术状态等情况。

### 2. 审阅核对资料

对被评估单位提供的申报资料进行审核、鉴别,对委估资产的产权证明文件进行全面的收集和查验,并与企业有关财务记录数据进行核对,对发现的问题协同企业做出调整。

### 3. 重点清查

根据申报资料,对主要资产和经营、办公场所进行了全面清查核实:对于其申报的金融资产和往来款项,清查核实其对账单、询证函及各项业务合同,确认其真实存在并分析其风险;对其申报的实物资产进行了现场勘查,电子设备、机器设备以抽查的形式进行盘点。同时,对专用设备,查阅了技术资料、决算资料和竣工验收资料;对租赁的办公场所,审阅其办公场所的租赁合同等。

### 4. 尽职调查访谈

通过尽职调查及高管访谈,了解企业产品的行业内的地位、市场份额,了解企业成本费用情况,分析企业未来发展趋势。针对企业申报的盈利预测数据,与企业管理人员进行座谈,就未来发展趋势尽量达成一致,进而通过查询同行业、同领域企业的主营业务、产品效果、毛利情况、市场分销渠道等方式进行核查验证。

### 5. 确定评估途径及方法

根据委估资产的实际状况和特点,确定资产评估的具体模型及方法。

### 6. 进行评定估算



根据达成一致的认识，确定评估模型并进行评估结果的计算，起草相关文字说明。

### (三) 评估汇总阶段

对各类资产及负债评估的初步结果进行分析汇总，对评估结果进行必要的调整、修改和完善。

### (四) 提交报告阶段

在上述工作基础上，起草初步资产评估报告，初步审核后与委托人就评估结果交换意见。在独立分析相关意见后，按评估机构内部资产评估报告审核制度和程序进行修正调整，最后出具正式资产评估报告。

## 九、 评估假设

本次评估中，评估人员遵循了以下评估假设：

### (一) 一般假设

#### 1. 交易假设

交易假设是假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。

#### 2. 公开市场假设

公开市场假设，是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

#### 3. 企业持续经营假设

企业持续经营假设是将企业整体资产作为评估对象而作出的评估



假定。即企业作为经营主体，在所处的外部环境下，按照经营目标，持续经营下去。企业经营者负责并有能力担当责任；企业合法经营，并能够获取适当利润，以维持持续经营能力。对于企业的各类经营性资产而言，能够按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用。

## (二) 特殊假设

1. 本次评估假设评估基准日外部经济环境不变，国家现行的宏观经济不发生重大变化；
2. 企业所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化；
3. 企业未来的经营管理团队尽职，并继续保持现有的经营管理模式；
4. 本次评估的各项资产均以评估基准日的实际存量为前提，有关资产的现行市价以评估基准日的国内有效价格为依据；
5. 本次评估假设委托人及被评估单位提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整；
6. 本次评估测算的各项参数取值不考虑通货膨胀因素的影响；
7. 可比企业与被评估单位在价值影响因素方面相同或者相似；
8. 可比企业与被评估单位均能够按交易时公开披露的经营模式、业务架构、资本结构持续经营；
9. 可比企业信息披露真实、准确、完整，无影响价值判断的虚假陈述、错误记载或重大遗漏；
10. 评估人员仅基于公开披露的可比企业相关信息选择对比维度及指标，不考虑其他非公开事项对被评估单位价值的影响。

当上述假设条件发生变化时，评估结果一般会失效。



## 十、 评估结论

根据有关法律法规和资产评估准则，经实施清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序，采用资产基础法和市场法，对 Advanced Assembly Materials International Limited 股东全部权益在评估基准日 2024 年 9 月 30 日的价值进行了评估，得出如下结论：

### (一) 市场法评估结论

评估师采用市场法进行评估，未发现近期公开市场上存在与评估对象相同或近似的可比交易案例，但存在同行业可比上市公司，因此使用可比上市公司法进行评估。评估师对可比上市公司按照业务结构、经营模式、企业规模、资产配置、企业生命周期、成长性、经营风险、财务风险等因素以及所选价值比率进行了分析和论证，并据此客观筛选可比公司进行对比、估值，但仍存在以下可能对市场法评估结论影响的情况：

本次评估，评估师按照业务结构、经营模式、企业规模、资产配置、企业生命周期、成长性、经营风险、财务风险等因素对可比上市公司进行了筛选，得到了近似可比的同行业可比上市公司。但被评估单位与可比上市公司具体细分领域和资产结构仍存在差别，尽管被评估单位与可比上市公司具有一定可比性，但这种差异仍然可能对评估结果造成一定影响。

考虑到被评估单位当前部分产品尚处于研发、未批量上市阶段，产品性能，技术参数尚未经过市场验证，被评估单位部分产品能否如管理层预期上市、实现预期毛利水平以及取得相应市场份额等具有一定不确定性。同时被评估单位新建造的 AMA 工厂当前处于产能爬坡期，由于当前整体半导体行业处于低谷期，未来产能爬坡效率同样具有一定不确定性。

采用市场法，得出被评估单位在评估基准日 2024 年 9 月 30 日的评



估结论如下：

合并口径股东全部权益账面值 296,593.77 万元，评估值 352,600.00 万元（百万取整），评估增值 56,006.23 万元，增值率 18.88%。

## （二）资产基础法评估结论

采用资产基础法，得出被评估单位在评估基准日 2024 年 9 月 30 日的评估结论如下：

总资产账面值 754,695.23 万元，评估值 823,424.99 万元，评估增值 68,729.76 万元，增值率 9.11%。

负债账面值 514,889.49 万元，评估值 514,889.49 万元，评估无增减值变化。

净资产账面值 239,805.74 万元，评估值 308,535.50 万元，评估增值 68,729.76 万元，增值率 28.66%。详见下表。

表23 资产评估结果汇总表

评估基准日：2024 年 9 月 30 日

金额单位：人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
1	流动资产	557,188.60	557,175.58	-13.02	0.00
2	非流动资产	197,506.63	266,249.41	68,742.78	34.81
3	其中：长期股权投资	146,797.59	222,581.71	75,784.12	51.62
4	投资性房地产	-	-	-	
5	固定资产	196.55	546.18	349.63	177.88
6	在建工程	96.30	96.30	-	-
7	无形资产	33,058.19	42,401.31	9,343.12	28.26
7-1	其中：土地使用权	-	-	-	
8	其他非流动资产	17,358.00	623.91	-16,734.09	-96.41
9	资产总计	754,695.23	823,424.99	68,729.76	9.11
10	流动负债	509,151.16	509,151.16	-	-
11	非流动负债	5,738.33	5,738.33	-	-
12	负债总计	514,889.49	514,889.49	-	-
13	净资产（所有者权益）	239,805.74	308,535.50	68,729.76	28.66



资产基础法评估结论详细情况见评估明细表。

### (三) 评估结果的差异分析

本次评估采用资产基础法测算出的净资产价值 308,535.50 万元，比市场法测算出的股东全部权益价值 352,600.00 万元，低 44,064.50 万元，低 12.50%。两种评估方法差异的原因主要是：

1.资产基础法评估是以资产的成本重置为价值标准，反映的是对资产的投入所耗费的社会必要劳动（购建成本），这种购建成本通常将随着国民经济的变化而变化。资产基础法评估结果与基准日实物资产的重置价值，以及账面结存的流动资产、其他非流动资产和负债价值具有较大关联，但难以反映不同类型资产之间的集合联动效应，以及管理层对企业资产组合的管理和获利能力等因素所体现的价值。

2.市场法评估是通过分析同行业或类似行业市场交易的情况来估算被评估单位的价值，反映了在正常公平交易的条件下公开市场对于企业价值的评定，该方法通常将受到可比公司和调整体系的影响。

综上所述，从而造成两种评估方法产生差异。

### (四) 评估结果的选取

相对于资产基础法而言，市场法虽然难以弥平市场及行业的波动性影响且评估对象与可比上市公司具体细分领域和资产结构存在一定差异，但市场法可以反映一定时期资本市场投资者对该企业所处行业的投资偏好，相对而言市场法评估参数来源更为客观，且易于被市场投资者所接受，因此本次评估以市场法的评估结果作为最终评估结论。

通过以上分析，由此得到 AAMI 合并报表口径下股东全部权益在基准日时点的价值为 352,600.00 万元（百万位取整，大写：叁拾伍亿贰仟陆佰万元整）。



## (五) 评估结论与账面价值比较变动情况及原因

被评估单位的市场法评估结果较其净资产账面值增值较高，主要原因是企业的主要价值除了账面的固定资产、存货、营运资金等有形资产外，还包括企业管理、人才团队、品牌优势、政策优惠等重要的无形资产，两类资产在被评估单位价值实现过程中协同发挥作用，使得被评估单位的价值在半导体行业整体发展过程中得到有效凸显，主要体现在以下几个方面：

### 1. 聚焦高端、全面覆盖的完备产品体系

半导体产品类型丰富，封装形式多种多样，被评估单位拥有完善的产品组合，可以满足客户的差异化需求。目前被评估单位拥有适配 TO、DIP、SOIC、SOP、QFP、DFN/QFN 等封装形式的引线框架产品，可广泛应用于 MCU、逻辑芯片、模拟芯片、通信芯片、光电器件、功率器件及传感器等。同时被评估单位聚焦高端市场，在高精密度和高可靠性等领域拥有较强的竞争优势，其产品满足汽车、计算、工业等关键应用市场的严苛品质要求，适应复杂恶劣的工作环境，保障芯片的使用寿命和稳定性能，高度契合当前全球快速增长的汽车、算力市场需求。

### 2. 优质且稳定的全球客户资源

基于其技术实力、丰富的产品组合和良好的客户服务，被评估单位与全球半导体各细分领域的头部客户构建了稳定的合作关系，全面进入汽车、计算、通信、工业、消费等下游领域，广泛覆盖全球主流的头部半导体 IDM 厂商和 OSAT 厂商。

### 3. 行业领先的研发能力和制造工艺

AAMI 的工程和研发团队拥有超过 40 年的引线框架设计和制造经验，积累了大量对半导体封装工艺、封装设备的理解并运用于引线框架设计，能够自主研发各类核心技术和关键工艺，保证持续的技术优势地



位。截至报告期末，AAMI 拥有 84 项已授权专利。

## 十一、 特别事项说明

### (一) 引用其他机构出具报告结论的情况

除审计报告外，未引用其他机构的报告出具报告结论。

### (二) 权属资料不全或权属瑕疵事项

截至评估基准日，未发现企业存在权属资料不全或权属瑕疵事项。

### (三) 评估程序受限或评估资料不完整的情形

截至评估基准日，未发现评估程序受限的情况。

### (四) 评估基准日存在的重要法律、经济等未决事项

截至评估基准日，未发现评估基准日存在的重要法律、经济等未决事项。

### (五) 抵押、担保及其或有负债（或有资产）等事项的性质、金额及与评估对象的关系

截至评估基准日，未发现对评估有重大影响的抵押、担保及其或有负债（或有资产）等事项。

### (六) 重大期后事项

截至评估基准日，未发现重大期后事项。

### (七) 本次评估对应的经济行为中，可能对评估结论产生重大影响的瑕疵情形

未发现本次评估对应的经济行为中，可能对评估结论产生重大影响的瑕疵情形。

### (八) 其他需要说明的事项



1. 评估师和评估机构的法律责任是对本报告所述评估目的下的资产价值量做出专业判断，并不涉及到评估师和评估机构对该项评估目的所对应的经济行为做出任何判断。评估工作在很大程度上，依赖于委托人及被评估单位提供的有关资料。因此，评估工作是以委托人及被评估单位提供的有关经济行为文件，有关资产所有权文件、证件及会计凭证，有关法律文件的真实合法为前提。

2. 评估师执行资产评估业务的目的是对评估对象价值进行估算并发表专业意见，并不承担相关当事人决策的责任。评估结论不应当被认为是对其评估对象可实现价格的保证。

3. 本次评估范围及采用的由被评估单位提供的数据、报表及有关资料，委托人及被评估单位对其提供资料的真实性、完整性负责。

4. 评估报告中涉及的有关权属证明文件及相关资料由被评估单位提供，委托人及被评估单位对其真实性、合法性承担法律责任。

5. 本次评估结论建立在评估对象产权所有者及管理层对企业未来发展趋势的准确判断相关规划落实，企业持续运营的基础上，如企业未来实际经营状况与经营规划发生偏差，且被评估单位及时任管理层未采取相应有效措施弥补偏差，则评估结论将会发生重大变化。特别提请报告使用者对此予以关注。

6. 评估范围仅以委托人及被评估单位提供的资产评估明细表为准，未考虑委托人及被评估单位提供清单以外可能存在的或有资产及或有负债；

7. 本次评估，评估师未考虑控股权和少数股权等因素产生的溢价和折价；

8. 房屋租赁情况

根据上海泽昌律师事务所出具的《上海泽昌律师事务所关于深圳至



正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》，截至评估基准日，AAMI 及其控制企业租赁的生产、办公物业情形如下：

序号	承租方	出租方	坐落位置	用途	租赁面积	租赁期限
1	AAMI	香港科技园公司	Units 311 to 312, 3/F, Building 10W, Phase Two, Hong Kong Science Park, Pak Shek Kok, New Territories, Hong Kong	产品、服务和技术的研究与开发	5,456 平方英尺	2024-09-01 至 2027-08-31
2	AMC	深圳市桥头股份合作公司	深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥二区 6 号厂房、10 号厂房第一层、12 号厂房、13 号厂房、14 号厂房、15 号厂房第二、第三层	生产	30,500 平方米	2021-06-01 至 2026-05-31
3		深圳市桥头股份合作公司	深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥二区 6 号空地	生产	2,837.2 平方米	2021-06-01 至 2026-05-31
4		深圳市桥头股份合作公司	深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥二区 12 号空地	生产	2,837.2 平方米	2021-06-01 至 2026-05-31
5		深圳市桥头股份合作公司	深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥二区 13 号空地	生产	2,837.2 平方米	2021-06-01 至 2026-05-31
6		深圳市桥头股份合作公司	深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥二区 14 号空地	生产	2,837.2 平方米	2021-06-01 至 2026-05-31
7		深圳市桥头股份合作公司	深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥二区 15 号空地	生产	2,837.2 平方米	2021-06-01 至 2026-05-31
8		广东奥源产业园有限公司	深圳市宝安区福海街道和平社区蚝业路 20 号 20-2 厂房 2 栋 4 楼	仓库	5,300 平方米	2023-03-16 至 2024-09-30 注
9		深圳市嘉晋物业管理有限公司	深圳市宝安区福海街道和平社区蚝业路 20 号 20-2 厂房 2 栋 4 楼	仓库	5,300 平方米	2024-06-01 至 2024-09-30 注
10		进峰贸易	西安蒜泥科技创新服务有限公司	西安市经济技术开发区凤城八路 176 号国金华府	办公	共享办公室，无固定面积
11	AMC		深圳市宝安区福海街道富桥二区 15 号厂房第三层第 5 室	办公	20 平方米	2024-06-01 至 2025-05-31
12	苏州水熊数字科技有限公司		苏州工业园区圆融时代广场 24 幢 802 室 803 单元	办公	65.8 平方米	2024-10-08 至 2026-10-07
13	AMB	Songpoom Benyakorn	98/23 M town pride, Chuam Sampan Road, Lam Phak Chi sub-district, Nong Chok district, Bangkok	办公	68 平方米	2024-10-01 至 2027-09-30
14	AMM	ASMPT	the Mukim of Plentong,	生产、办	435,447.54	2021-12-01 至



序号	承租方	出租方	坐落位置	用途	租赁面积	租赁期限
		Malaysia Sdn. Bhd.	District of Johor Bahru, State of Johor	公	平方英尺	2026-11-30
15		SJ Holdings Sdn. Bhd.	Parcel 6, Lot 198516 Jalan Keluli 11, Kawasan Perindustrian Pasir Gudang, 81700 Pasir Gudang, Johor	生产	147,999.31 平方英尺	自 AMM 实际占有租赁物业，且取得主管部门出具的完工合格证书之日起 12 年
16	AMSG	Woodlands Square Pte. Ltd.	6 Woodlands Square #08-04 Woods Square Tower 2 Singapore	办公	3,337 平方英尺	2022-10-20 至 2025-10-19
17	AMP	Maria Rebecca De Castro	Block 2, Lot 12, South Hampton, RSBS Boulevard, Barangay Balibago, Santa Rosa City, Laguna	办公	32 平方米	2024-10-10 至 2025-10-10

注：根据 AAMI 的说明，上表第 8 项租赁物业自 2024 年 6 月 1 日起变更为 AMC 向深圳市嘉晋物业管理有限公司租赁（即上表第 9 项），该等租赁物业到期后不再续租。

### (1)历史遗留违法建筑

上表租赁物业中第 2 项和第 11 项租赁物业所涉房产属于深圳市农村城市化历史遗留违法建筑，最终出租方均为深圳市桥头股份合作公司（以下简称“桥头股份”）。根据《商品房屋租赁管理办法》第六条规定，AMC、ETL 租赁上述违法建筑，存在可能由于未经批准建设而导致租赁合同部分无效的风险。

基于上述事项，AMC 就租赁上述产权存在瑕疵的租赁房产已取得如下证明文件：

1)2009 年 11 月 23、24 日，宝安区福永街道农村城市化历史遗留违法建筑信息普查工作办公室向桥头股份出具《深圳市农村城市化历史遗留违法建筑普查申报收件回执》，桥头股份已就该等历史遗留违法建筑向其进行信息申报。

2)2024 年 11 月 22 日，深圳市宝安区福海街道办事处出具情况说明，确认：AMC 租赁物业属于农村城市化历史遗留违法建筑，现场暂未发现新增违法建设行为。根据现行法定图则，租赁物业地块规划性质为普通工业用地（M1）。

3)2024 年 11 月，桥头股份出具《确认函》，确认：截至《确认函》



出具日，AMC 向桥头股份租赁物业尚未被纳入未来五年城市更新单元计划拟拆除范围。桥头股份未就租赁物业所涉土地申请以拆除重建方式实施城市更新或以利益统筹方式实施土地整备。租赁物业不存在被主管部门拆除的风险。《房地产租赁合同》到期后，桥头股份会继续与 AMC 续签租赁物业，《房地产租赁合同》不存在到期无法续签的风险。

4)2025 年 1 月 8 日，深圳市宝安区城市更新和土地整备局出具《证明》，确认：AMC 租赁的 6 号厂房、10 号厂房、12 号厂房、13 号厂房、14 号厂房及 15 号厂房（即上表第 2 项租赁房产）尚未经深圳市宝安区城市更新和土地整备局纳入城市更新拆除重建及土地整备计划。

5)2025 年 2 月 12 日，深圳市公共信用中心出具《先进半导体材料（深圳）有限公司公共信用信息查询报告（无违法违规记录版）》，确认：AMC 在最近三年不存在因租赁厂房而受到行政处罚情形。

除上述有关部门出具的证明文件外，根据深圳市规划和自然资源局公告的《深圳市宝安 201-04&05 号片区[福永桥头地区]法定图则》，租赁物业所在地块为工业用地。

## (2)租赁备案

截至评估基准日，AMC、ETL 上述租赁物业存在未办理房屋租赁登记备案手续的情形。根据《商品房屋租赁管理办法》（住房和城乡建设部令第 6 号）第十四条、第二十三条的规定，房屋租赁合同订立后三十日内，房屋租赁当事人未到租赁房屋所在地直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门办理房屋租赁登记备案的，直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门责令限期改正；个人逾期不改正的，处以下一千元以下罚款；单位逾期不改正的，处以下一千元以上一万元以下罚款。截至本报告书签署日，AMC 和 ETL 未因未及时办理租赁备案登记被主管部门责令限期改正或因此受到行政处罚。



根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条、《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释（2020修正）》第五条的规定，AMC、ETL就上述租赁房屋未办理房屋租赁登记备案手续不影响上述房屋租赁合同的法律效力，AMC、ETL可以基于依据生效的租赁合同使用该等租赁房屋，在租赁合同约定的租赁期内不存在因此被要求停产停工的风险，对AMC、ETL未来生产经营不会产生重大不利影响。

综上所述，AMC、ETL租赁上述瑕疵房产预计将稳定、持续使用，该等瑕疵房产对AMC、ETL的生产经营不会产生重大不利影响。本次评估未考虑租赁瑕疵事项对评估的影响，提请报告使用者注意。

#### 9. 行政处罚及合法合规情况

根据上海泽昌律师事务所出具的《上海泽昌律师事务所关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》，最近三年，AAMI及其控制企业受到行政处罚或者刑事处罚情况如下：

序号	责任主体	案号	案件情况	处罚情况
1	AMM	JA-63ES-3-03/2022	2021年3月9日，AMM向水中排放工业废水的含铜浓度为4.5mg/l，超过了允许限值1mg/l。	2022年4月11日，马来西亚法院判决AMM承担罚金30,000元林吉特。同日，AMM已完成上述罚金缴纳。
2	AMM时任董事 Wong Kee Yoon	JA-63ES-4-03/2022	2021年3月9日，AMM向水中排放工业废水的含铜浓度为4.5mg/l，超过了允许限值1mg/l。	2022年4月11日，马来西亚法院判决Wong Kee Yoon承担罚金30,000元林吉特。同日，Wong Kee Yoon已完成上述罚金缴纳。
3	AMM	JA-63ES-94-11/2022	2021年11月29日，AMM向水中排放工业废水的含铜浓度为1.2mg/l，超过了允许限值1mg/l。	2022年12月15日，马来西亚法院判决AMM承担罚金45,000元林吉特。同日，AMM已完成上述罚金缴纳。
4	AMM时任董事 Wong Kee Yoon	JA-63ES-93-11/2022	2021年11月29日，AMM向水中排放工业废水的含铜浓度为1.2mg/l，超过了允许限值1mg/l。	2022年12月15日，马来西亚法院判决Wong Kee Yoon承担罚金40,000元林吉特。同日，Wong Kee Yoon已完成上述罚金缴纳。

上述案件事实发生后，AMM积极实施相关补救工作并履行环境修复义务，包括：1）聘请具备资质的第三方机构就环保设施整改情况出具



整改报告，并提交马来西亚环保部门审查；2) 完成河流污染清理、修复工作；3) 委托有资质的第三方为其提供污染物处理服务；4) 聘请有环保相关资质的工作人员负责环保事宜；5) 安装污染物自动化警示设备、监测设备、过滤设备等；6) 提高日常污染物检测频率，并留存相应检测文件；7) 制定并完善了与环保、污染源监控相关的内控制度。

根据《AMM 法律意见书》，就上述环保案件，AMM 已进行整改并确认：1) AMM 及其时任董事已足额缴纳上述处罚罚金；2) AMM 已根据主管部门要求完成整改措施，且整改情况已符合法律法规的相关要求；3) AMM 已取得环保、安全生产等生产经营所需的全部资质文件；4) 上述处罚对 AMM 的日常生产经营不存在重大不利影响；5) 除上述处罚外，AMM 自 2021 年 1 月 1 日至今不存在其他刑事处罚及行政处罚情况，AMM 不存在任何正在进行的与环保、安全生产相关的诉讼、争议或被立案调查。

综上所述，鉴于 AMM 已及时采取整改措施并履行完成环境修复义务，案件现已完结，上述处罚不会对 AMM 的生产经营构成重大不利影响，本次评估未考虑该行政处罚及合法合规情况对评估工作的影响，提请报告使用者注意。

## 十二、 评估报告使用限制说明

(一) 本评估报告只能用于本报告载明的评估目的和用途。同时，本次评估结论是反映被评估单位在本次评估目的下，根据公开市场的原则确定的现行公允市价，没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方可能追加付出的价格等对评估价格的影响，同时，本报告也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格的影响。当前述条件以及评估中遵循的持续经营原则等其它情况发生变化时，评估结论一般会失效。评估机构不承担由于这些条



件的变化而导致评估结果失效的相关法律责任。

(二) 本评估报告成立的前提条件是本次经济行为符合国家法律、法规的有关规定，并得到有关部门的批准。

(三) 本评估报告只能由评估报告载明的评估报告使用人使用。评估报告的使用权归委托人所有，未经委托人许可，本评估机构不会随意向他人公开。

(四) 委托人或者其他资产评估报告使用人未按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估师不承担责任；

(五) 除委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人；

(六) 未征得本评估机构同意并审阅相关内容，评估报告的全部或者部分内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，法律、法规规定以及相关当事方另有约定的除外。

(七) 资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论。评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对其评估对象可实现价格的保证。

(八) 评估结论的使用有效期：根据资产评估相关法律法规，涉及法定评估业务的资产评估报告，须委托人按照法律法规要求履行资产评估监督管理程序后使用。评估结果使用有效期一年，自评估基准日 2024 年 9 月 30 日起计算，至 2025 年 9 月 29 日止。超过一年，需重新进行资产评估。

### 十三、 评估报告日

评估报告日为二〇二五年二月二十八日。



(此页无正文)



资产评估师:



资产评估师:



二〇二五年二月二十八日



## 附件

1. 经济行为文件（复印件）；
2. 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《先进封装材料国际有限公司审计报告》（德师报(审)字(25)第 S00067 号）；
3. 委托人和被评估单位企业法人营业执照（复印件）；
4. 被评估单位涉及的主要权属证明资料（复印件）；
5. 委托人及被评估单位承诺函；
6. 签字资产评估师承诺函；
7. 中联资产评估咨询（上海）有限公司备案文件（复印件）；
8. 中联资产评估咨询（上海）有限公司《从事证券服务业务资产评估机构备案名单》（复印件）；
9. 中联资产评估咨询（上海）有限公司企业法人营业执照（复印件）；
10. 资产评估师职业资格证书登记卡（复印件）；

